

適用規格									
定 格	使用温度範囲	-30℃～+85℃（注1）			保存温度範囲	-10℃～+60℃（注3）			
	使用湿度範囲	40%～80%（注2）			保存湿度範囲	40%～70%（注3）			
	電 圧	AC 250 V	UL・CSA	AC 30 V					
	電 流	2 A	定格	2 A					
性 能									
	項 目	試 験 方 法			規 格		QT	AT	
構造	外観、構造、仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。			図面と合致していること。		○	○	
	表示	目視にて確認する。					○	○	
電氣的性能	接触抵抗	100 mA(DC又は 1000 Hz)で測定する。			30 mΩ以下		○	—	
	絶縁抵抗	DC 500 Vで測定する。			1000 MΩ以上		○	—	
	耐電圧	AC 650 Vの電圧を 1 分間印加する。			せん絡・絶縁破壊がないこと。		○	—	
機械的性能	繰り返し動作	50 回の抜き差しを行う。			①接触抵抗： 30 mΩ以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—	
	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 2 時間試験する。			① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—	
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。			① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—	
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度 40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。			①接触抵抗： 30 mΩ以下 ②絶縁抵抗： 500 MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—	
	温度サイクル	温度 -55 → +5～+35 → +85 → +5～+35℃ 時間 30 → 5～15 → 30 → 5～15分 を 5 サイクル 試験する。			①接触抵抗： 30 mΩ以下 ②絶縁抵抗： 1000 MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—	
	塩水噴霧	温度 35±2℃、濃度（重量比）5%で 48 時間連続噴霧後、試験する。			①接触抵抗： 60 mΩ以下 ②はなはだしい腐食がないこと。		○	—	
	二酸化硫黄ガス	濃度 10 ppm、温度 40℃、湿度 70～80%で 96時間放置後、試験する。 （JEIDA-39に準拠）			①接触抵抗： 60 mΩ以下 ②はなはだしい腐食がないこと。		○	—	
	半田耐熱性	【 フロ-半田付けの場合 】 半田温度 260℃、10 秒間で試験する。 【 手半田の場合 】 半田ごてで 300℃、2 秒以内の条件にて 半田付けを行う。 但し、端子に力を加えないこと。			外観の変形及び端子等に 著しいガタがないこと。		○	—	
	半田付け性	半田温度 230±5℃、 浸漬時間 3秒間の半田付けを行なう。			半田浸漬面の 95 %以上が 新しい半田で濡れていること。		○	—	
備考									
(注1) 通電時の温度上昇を含みます。									
(注2) 結露のないこと。									
(注3) 基板搭載前の未使用品に対する長期保存状態に適用。 基板搭載後、輸送時の一時保管は使用温湿度範囲を適用。									
	△の数	訂正記事			設計		検図		年月日
△									
試験規格の記載のない試験方法はJIS G 5402を適用している。						承認	TY.OMA		06.08.09
						検 図	HK.UMEHARA		06.08.09
						担 当	NS.HIROSE		06.08.09
						製 図	AK.MIURA		06.08.08
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目					図番	SLC4-020835-04			
HRS	製品規格表				製品名	DF11-8DP-2DS (56)			
	ヒロセ電機株式会社				製品コード	CL543-0535-7-56		△	1/1